

# МИКРОПОЛОСКОВЫЕ ПЛАТЫ НЧ, ВЧ И СВЧ ГИС

**С**-Компонент изготавливает микрополосковые платы ГИС НЧ, ВЧ и СВЧ-диапазона, помогая своим Заказчикам не только снижать себестоимость серийных изделий, но и реализовывать сложные проекты, требующие нестандартных технологических решений.

## Подготовка подложек:

- Шлифовка, полировка
- Лазерное скрайбирование, резка, прошивка отверстий, контурная обработка
- Алмазная резка и профилирование

Магнетронное, ионно-плазменное и вакуумное термическое напыление:

- Проводящие слои Cu, Al и др. с подслоем Cr, V или Ti. Металлизация лицевой и экранной поверхностей, отверстий и торцов (в т.ч. селективная)
- Пленочные резисторы из кремниевых сплавов с абсолютно повторяемым ТКС

## Прецизионная фотолитография:

- Мин. ширина проводника/зазор — 50 мкм
- Точность изготовления до +0/-5 мкм

## Финишные операции:

- Функциональная лазерная подгонка и лазерная юстировка номиналов пленочных резисторов с точностью до 0,1%
- Нанесение гальванических покрытий
- Нанесение защитных покрытий
- Разделение групповых заготовок на платы

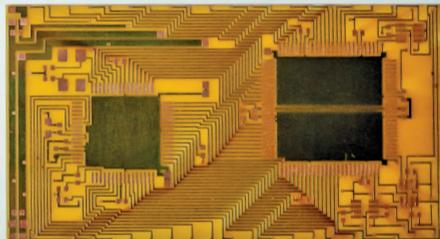
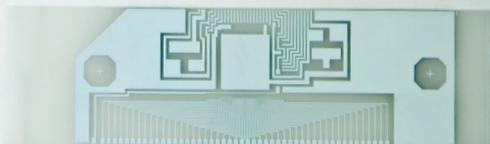
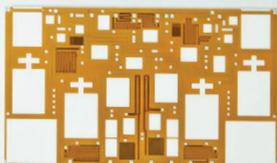
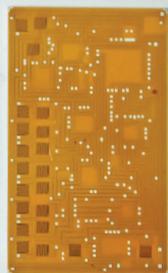
Дополнительно нашим предприятием разработана технология формирования прецизионных углублений в объеме керамической подложки для монтажа кристаллов СВЧ МИС:

- Высокая точность габаритов углубления (5 мкм)
- Возможность формирования стенок углублений с заданным углом наклона
- Максимальная точность посадки кристалла и копланарность его лицевой стороны с топологическим рисунком металлизации

Свяжитесь с нами для получения подробной информации и размещения заказа.

**Мы отвечаем быстро.**

*Техническая информация представлена на обратной стороне.*



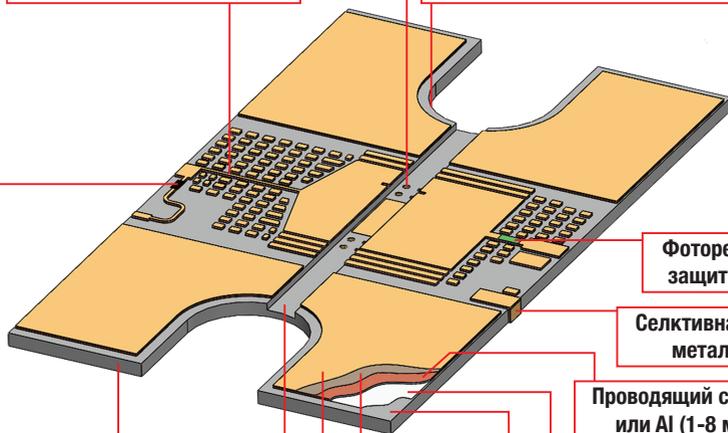
# МИКРОПОЛОСКОВЫЕ ПЛАТЫ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Резисторы из кремниевых сплавов.  
Подгонка с точностью до 0,1%

Ширина/зазор 50 мкм  
с точностью до +0/-5 мкм

Переходные отверстия от  $\varnothing$  0,1мм

Лазерная и алмазная обработка.  
Пазы, слоты, монтажные отверстия и пр.



Фоторезистивные  
защитные маски

Селктивная торцевая  
металлизация

Проводящий слой Cu  
или Al (1-8 мкм)

Адгезионный подслой Cr, V  
или Ti (100-200 Ом/кв)

Шлифованная и полированная  
(до Ra = 0,005 мкм) поверхность

Барьерный слой Ni

Защитно-монтажный  
слой Au (1-4 мкм)

Подложка BK-96,  
BK-100, AlN или др.

Прецизионное углубление  
для монтажа кристалла СВЧ МИС

Команда С-Компонент обеспечит незамедлительный ответ, предоставит развернутую техническую консультацию, поможет в выборе и предложит наиболее подходящий и экономичный вариант изготовления.

**МЫ ПОМОЖЕМ!**

Система менеджмента качества соответствует требованиям  
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)

+7 (495) 663-93-17  
inform@c-component.ru  
www.c-component.ru

 **С-КОМПОНЕНТ**

125476 Россия, г.Москва,  
ул. Василия Петушкова, 8